



Title	新規微小引張試験法開発への予備的検討 [全文の要約]
Author(s)	山下, 航司
Description	この博士論文全文の閲覧方法については、以下のサイトをご参照ください。 https://www.lib.hokudai.ac.jp/dissertations/copy-guides/
Degree Grantor	北海道大学
Degree Name	博士(歯学)
Dissertation Number	甲第15012号
Issue Date	2022-03-24
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/85927
Type	doctoral thesis
File Information	Koji_Yamashita_summary.pdf



学位論文内容の要約

学位論文題目

新規微小引張試験法開発への予備的検討

博士の専攻分野名称

博士（歯学）

氏名 山下 航司

大白歯冠用CAD/CAMレジブロックは、近年健康保険適応となり、CAD/CAM冠としての使用頻度が増加している。CAD/CAM冠の増加に合わせて、レジコアシステムもまた広く使用されるようになった。しかし時にCAD/CAM冠の脱離が発生していることもまた報告されている。CAD/CAM冠とレジコアとの接着には接着性レジセメントが多く使用されており、その性能はCAD/CAM冠修復の臨床成績に少なからず影響すると考えられる。私たちの研究グループは、大白歯CAD/CAM冠用レジブロックとレジコア間のレジセメントの微小引張強さ(μ TBS)の評価、検討を行ってきた。その際、 μ TBS試験時には、接着面への水、酸素による影響が考えられる。また、従来の μ TBS試験では接着処理後にビーム作製を行うため、試料作成時の切断方法の影響も考慮する必要がある。そこで、本研究では、まず従来型 μ TBS試験において、試片作成時の空気及び水中保管時の水に接するブロック外周部分と接しないブロック中央部分に分けて μ TBS、ヌーブ硬さ(KHN)の比較を行うと同時に、接着操作前にビーム作製を行う新規 μ TBS試験を考案し、従来型との μ TBSの比較、検討を行った。また、対照群としてCAD/CAM用レジブロックに対するボンディングレジによる接着を行い、レジセメント群との比較を行った。

CAD/CAM用レジブロックはエステライトPブロック(トクヤマデンタル)、レジコアはエステコア(トクヤマデンタル)を使用した。レジセメントはエステセムII(トクヤマデンタル)、パナビアV5(クラレノリタケデンタル)の2種類を使用した。対照群として、セルフエッチングプライマーのクリアフィルメガボンド2(クラレノリタケデンタル)とコンポジットレジンのクリアフィルAP-X(クラレノリタケデンタル)を使用した。また、新規 μ TBS試験に関して、被着面積を規定するために用いたテフロンテープは、アズフロンテープ(アズワン)を使用した。

従来型 μ TBS試験法の接着手順は各製造者の指示に従い行った。エステセム群では、CAD/CAM用レジブロック、レジコアブロックともにボンドマーライトレス(トクヤマデンタル)を塗布し、エアブローの後、乾燥させた。続いてエステセムIIを各ブロックに塗布し、10Nの負荷下で接着した。マイクロブラシファイン(松風)を用いて余剰セメントを除去し、各方向から20秒ずつ光照射を行い、10Nの負荷下で3分間保持した。続いてパナビア群では、CAD/CAM用レジブロックにエッチング剤であるKエッチャントシリンジ(クラレノリタケデンタル)を塗布、5秒後に水洗、乾燥後、補綴物用プライマーとしてセラミックプライマープラス(クラレノリタケデンタル)を塗布し、エアブローの後、乾燥させた。レジコアブロックにはセルフエッチングプライマーとしてトゥースプライマー(クラレノリタケデンタル)を塗布し、20秒後、エアブローを行い、乾燥させた。続いてパナビアV5を各ブロックに塗布し10Nの負荷下で接着した。マイクロブラシファイン(松風)を用いて余剰セメントを除去し、各方向から20秒ずつ光照射を行い、10Nの負荷下で3分間保持した。対照群(メガボンド群)では、CAD/CAM用レジブロックに2ステップセルフエッチングプライマーのクリアフィルメガボンド2(クラレノリタケデンタル)を塗布し、エアブローの後、乾燥させ、10秒間の光照射を行った。続いてコンポジットレジンのクリアフィルAP-XをCAD/CAM用レジブロックに直接築盛し、各方向から20秒ずつ光照射を行った。ここまでで得られた試料を37°Cの蒸留水中で24時間保管し、切断機であるIsomet1000(Buehler)を用いて、断面積1mm \times 1mmのビームを作成し、それぞれのビームを中央部分と外周部分に分類した。これにより、各材料から得られたビームは、中央エステセム群、外周エステセム群、中央パナビア群、外周パナビア群、中央メガボンド群、外周メガボンド群にそれぞれ分類された。

新規 μ TBS試験法は、断面積2mm \times 2mmのビーム作成から行った。アルミナサンドブラスト処理を行った各ブロックから、切断機を用いて、断面積2mm \times 2mmのCAD/CAM用レジビームとレジコアビームをそれぞれ作成した。CAD/CAM用レジビームの接着面に直径1.13mmの正円形(\approx 1mm²)の穴を開けた厚さ0.08mmのテフロンテープであるアズフロンテープ(アズワン)を貼り付けた。続いてそれぞれのビームの接着面に従来型試験法と同様の処理を行った後、各レジセメントにより、CAD/CAM用レジビームとレジコアビームを引張試験装置EZ-S(島津)により10Nの負荷下で接着した。対照群においても接着面上記と同様の処理を行い、CAD/CAM用レジビームに直接コンポジットレジンを築盛、試料作製を行った。各試料は37°Cの蒸留水中で24時間保管され、新規エステセム群、新規パナビア群、新規メガボンド群にそれぞれ分類された。

得られたすべてのビームを引張試験装置により、通法に従い μ TBSを測定した。また、接着界面と μ TBS

試験後の破断面を走査電子顕微鏡（SEM）により観察を行った。

レジンセメント硬さ測定では、各レジンセメントを内径9mm、厚さ4mmのモールド内に填入し、上下試験面をセルロイドストリップスで覆い、ガラス板で挟み、1kgの荷重で1分間圧接後、ガラス板上下面をそれぞれ60秒間、計120秒光照射し重合させ、モールドを除去した。37℃蒸留水中に24時間保管後、その上下面を流水下で鏡面研磨したものを試料とした。その後、微小硬度計MVK-C（明石製作所）を使用して、荷重25g、負荷時間30秒間の条件でレジンセメントのKHNを計測した。よって、KHNは中央部分エステセム、外周部分エステセム、中央部分パナビア、外周部分パナビアの4群に分類された。

μ TBS試験と硬さ測定により得られたすべてのデータは、one-way ANOVA、Tukey HSD testにより分析された。

本研究の結果、新規 μ TBS試験の μ TBSは、従来型 μ TBS試験の中央部分における μ TBSと比較して低下したが、外周部分における μ TBSと比較した場合には有意差がみられなかった。このことは新規 μ TBS試験及び従来型 μ TBS試験の外周部分が中央部分に比較して水中保管における水と空気中の酸素による重合阻害を大きく受けていることによると考えられる。また、SEM観察から、従来型 μ TBS試験の外周レジンセメント群と新規レジンセメント群においてレジンセメントの破断面が中央レジンセメント群と異なった像が観察された。このことから、レジンセメントの性状が μ TBSの低下に関連すると予想される。それに加えて、レジンセメント外周部分のKHNが中央部分のそれに比較して低下したことも μ TBSの低下に関連すると思われる。また、一方で、ボンディングレジンを用いた場合の新規 μ TBS試験法及び従来型 μ TBS試験法の外周部分の μ TBSは中央部分の μ TBSと比較して同程度であり、レジンセメントの μ TBSに比較して高い値であった。

本研究における新規 μ TBS試験法では、水中保管におけるレジンセメントの重合阻害が課題であると考えられる。